

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>网络会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	网上投资者（深交所“走进深南电路”线上活动暨全景云调研）
时间	2021年4月30日
地点	网络会议（网络平台：全景网）
上市公司接待人员姓名	董事长：杨之诚；副总经理、董事会秘书：张丽君。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>环节：</p> <ol style="list-style-type: none">1、活动开场2、行业探讨：PCB行业国内外发展现状、竞争格局以及未来发展趋势3、实地探访：参观深南电路总部4、公司分享：董事长介绍公司5、互动交流：公司高管回答投资者提问 <p>互动交流主要内容：</p> <p>Q1、公司在全球PCB企业中位列第8名，业务遍布全球，请问公司的境内外业务情况如何？公司在行业里面有哪些竞争优势？</p> <p>2020年，公司实现营收116亿元，其中境外销售收入31亿元，占公司营业近27%，金额同比有一定增长，占比保持相对平稳。公司专注于电子互联领域，深耕印制电路板行业，经过37年的发展，形成独特的“3-In-One”商业模式和完整的产业布局，具有领先的技术研发实力和先进的工艺技术水平，并与众多大客户保持长期稳定合作关系，拥有扎实</p>

的市场基础。此外，公司在运营管理方面的能力持续提升，并积极推进智能制造。

Q2、近年来，公司 PCB 业务占营业收入的比例保持相对平稳，2020 年 PCB 业务收入已突破 80 亿元，请问公司在 PCB 业务发展方面做了哪些努力？未来的拓展的方向是哪些呢？

从市场方面看，公司 PCB 业务在通信领域把握已有优势的基础上，近年来加大在数据中心、汽车电子等市场的开发力度。技术研发方面，公司积极跟进大客户产品研发过程；为满足市场需求，公司自上市以来投资建设新工厂，包括南通一期、南通二期及目前正在建的南通三期工厂，并不断推进工厂智能化建设。未来，PCB 业务将持续深挖 5G 建设及商用市场机会，保持并持续扩大先发优势。同时，公司将加快突破数据中心、汽车电子等市场。

Q3、请简要介绍下公司封装基板业务。公司对于封装基板业务产能如何规划？存储芯片类开始逐步放量，公司还在除存储以外的哪些领域有所布局？

公司 2009 年进入封装基板领域，目前公司共有 3 家封装基板工厂，其中深圳两家封装基板工厂，产能约 30 万 m²/年，无锡一家封装基板工厂，达产后产能预计 60 万 m²/年。公司生产的封装基板产品主要分为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理器芯片封装基板和高速通信封装基板等五类。目前，公司在声学类微机电系统封装基板产品在细分市场上处于领先地位；公司将进一步加大存储类封装基板的开拓力度，同时加快 FC-CSP 基板的技术突破，并推动国内外关键客户的开发与合作。

Q4、公司近期公布 2020 年年报和 2021 年一季报，2020 年营收和利润水平均保持了两位数增长，今年一季度公司业绩出现了一定的下滑，公司对此是如何看待的？未来公司在提升业绩方面，还有哪些方面的努力？

一季度归母净利润波动的原因主要包括：受通信市场需求调整的影响，公司产能利用率较同期下降，单位固定成本分摊增加；产品结构调整，低毛利产品较同期增加；公司研发费用较同期增长。从产能利用率情况来看，PCB、PCBA 业务综合产能利用率在春节后较前期有所提升，封装基板业务产能利用率持续保持较高水平。从今年应对策略来看，公司将抓住 5G 通信、数据中心、汽车等相关市场的结构性机会，并不断强化内部运营管理，

聚焦提升技术能力，不断提升产品竞争力。

Q5、目前上游原材料价格存在波动，公司成本上行的压力如何？采取了哪些措施来解决这个问题？相关的，公司今年一季度在存货方向计提减值金额较大，减值的原因以及公司改进措施，能否展开介绍一下？

公司目前部分原材料价格上涨。公司会通过强化内部成本费用管理、优化产品结构等方式降低原材料价格变动带来的影响。存货方面，由于南通数通二期、无锡基板工厂产能爬坡，公司存货规模会相应增加。另一方面，公司为保障供应链安全，预备一部分原材料的安全库存。

Q6、请问公司用在汽车方面的产品毛利率能达到多少？净利率能到多少？谢谢。

您好。目前汽车电子业务占比较小。公司已积极投入汽车电子相关技术研发，积累生产能力，并已与国内外部分知名厂商开展合作。感谢您的关注。

Q7、公司在产业链布局方面，未来的规划是怎样的？想听您详细的说一下？

您好。公司始终专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。公司在PCB业务方面将持续深挖5G建设及商用市场机会，保持并持续扩大先发优势。同时，公司将加快突破数据中心、汽车电子等市场。电子装联业务立足已有战略客户，持续优化市场结构，拓展通信、医疗、汽车领域优质项目。封装基板业务将持续保持细分市场领先优势，大力开拓存储类封装基板等重要市场，加快FC-CSP产品技术突破，推动与国内外关键客户开发与合作。感谢您的关注。

Q8、目前公司国内市场占有率、全球市场占有率是多少？另外，您认为公司的资本价值提升和目前的产品价值提升的关联度大吗？

您好。公司聚焦高中端制造，所生产的背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、封装基板等产品技术含量高，应用领域相对高端，具有较强的竞争力，占据细分市场领先地位。公司的资本价值取决于多方面因素的影响。公司将努力做好经营管理工作，为股东创造更大价值。感谢您的关注。

Q9、张总，进入二季度，公司产能利用率较上季度是否增长？订单生产排单到几月份了？

您好。目前公司 PCB、PCBA 业务综合产能利用率在春节后较前期有所提升，封装基板业务产能利用率持续保持较高水平。感谢您的关注。

Q10、目前的产能能达到多少？计划 2021 年的产能情况将会是多少呢？

您好。公司原有工厂 PCB 产能约 200 万平米/年，此外，南通数通二期工厂目前处于产能爬坡阶段，预计达产后新增产能 58 万平方米/年；南通三期预计将于 2021 年 4 季度投产。公司也将持续通过技术改造提升产能。感谢您的关注。

Q11、杨总，中美贸易战的持续，对贵司产生的影响，您觉得公司这边是否已经消化掉了，最坏的情况已经发生不会更坏了呢？

您好，公司目前经营正常，并将持续密切关注外部环境变化，注意风险防范。感谢您的关注。

Q12、公司业务挺好，但是为何业绩不能体现，公司领导对去年业绩满意吗？

您好，公司将努力做好经营管理工作，为股东创造更大价值。感谢您的关注。

Q13、清洁生产方面，请问您觉得公司最大的成就是什么？未来的方向又是什么呢？

您好，公司坚持将清洁生产、绿色制造的理念融入产品设计、采购、生产、废弃的全生命周期。公司配置了行业内最为先进与完善的废水、废气处理系统，公司于 2008 年即成立清洁生产委员会，并下设节能、降耗、减排三个专项小组，大力投入、规范管理，持续推动公司清洁生产发展工作，并依据国家及地方的环保法律法规，制定了《环境保护责任制制度》等环保管理制度。因环保管理理念领先、软硬件管理系统完备，公司被纳入国家首批“资源节约型、环境友好型”示范企业。2020 年全年，公司三个生产基地各项污染因子控制达标率均为 100%，单位面积水耗、能耗优于行业清洁生产一级标准，碳排放强度指标优于政府制定的目标，清洁生产能力在行业内保持领先地位。公司把企业的使命、愿景、价值观与社会责任紧密结合在一起，在未来的运营生产中，继续追求和谐、健康、可

持续的发展。感谢您的关注。

Q14、PCB 行业有很多细分行业，公司的业务偏向通讯类的，请问公司有没有向其它类别衍生的计划？

您好。公司 PCB 业务下游应用领域广泛，覆盖通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域。公司在坚持深耕通信市场的基础上，重点布局数据中心、汽车电子等领域。感谢您的关注。

Q15、公司在汽车领域有多少技术储备，预计未来三年能占总营收比例多少？

您好。公司掌握汽车领域 PCB 所涉及的关键技术，也获得客户认可，公司与部分国际大客户已建立稳定合作关系，并已启动南通三期汽车专业工厂产线建设，建成后将进一步拓展公司在汽车市场的发展空间。感谢您的关注与支持。

Q16、什么时候考虑员工持股？

您好。感谢您的建议，如有相关情况公司将按照相关规定履行信息披露义务。

Q17、电路板什么时候提价？

您好。公司遵循产业链共赢的定价策略，重视公司长期稳健运营，公司将根据具体的项目情况考虑产品的价格，提升与相关客户的开发力度与合作深度。感谢您的关注。

Q18、你好，杨董。从去年开始，PCB 生产需要的各项原材料大涨，一季报公司增收不增利，为了应对原材料上涨的压力，公司采取了哪些措施？公司目前和下游客户是否就产品涨价进行过协商？协商结果或进展如何？

您好。公司作为原材料供应商战略客户，在原材料供给上能够获得一定保障。公司将加强与供应商、客户的沟通协商，共同面对材料价格上涨压力，努力实现共赢。感谢您的关注。

Q19、张总贵司 4 季度即将投产的南通三期项目，预计可为公司 2021 年度业绩带来多少影响，长期来看您如何评估？

您好，南通三期项目主要面向汽车电子领域产品，预计 2021 年 4 季度投产。由于汽车电子类产品标准高，认证周期较长，工厂后续产能爬坡仍需要一定时间，但产品定型后作为供应商的稳定性也更强。长期来看，相比于传统的，公司更专注于新能源汽车和智能驾驶两个细分领域。未来伴随各类终端应用（车联网、物联网）的涌现，汽车也可能成为大的移动终端，公司在通信领域的技术优势可进一步延伸，如大功率散热解决方案，同样应用于新能源汽车；ADAS 中会采用的高频传输技术，是实现自动驾驶的关键。感谢您的关注。

Q20、另外，在印制电路板领域，您认为公司国内最大的竞争对手是哪家呢？

您好，PCB 属于高度定制化产品，由于不同项目所用产品有差异，公司与竞争对手的竞争主要表现在具体产品项目上。公司深耕印制电路板行业，形成独特的“3-In-One”商业模式和完整的产业布局，具有领先的技术研发实力和先进的工艺技术水平，并与众多优质客户保持长期稳定合作关系，具有一定的核心竞争力。感谢您的关注。

Q21、杨董，请问公司后续是否有可能往芯片研发的方向发展？您对公司未来 3-5 年的战略是如何规划的？

您好，公司目前不涉及芯片研发业务，公司将持续专注于电子互联领域，围绕核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为电子互联技术领导者。感谢您的关注。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单

无

日期

2021 年 5 月 6 日